

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013 年 10 月 3 日(03.10.2013)



(10) 国際公開番号

WO 2013/146700 A1

- (51) 国際特許分類:
C08L 63/00 (2006.01) C08J 5/24 (2006.01)
B32B 15/08 (2006.01) C08K 3/00 (2006.01)
B32B 15/092 (2006.01) C08K 3/10 (2006.01)
C08G 59/40 (2006.01) C08L 61/14 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/058625
- (22) 国際出願日: 2013 年 3 月 25 日(25.03.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-080722 2012 年 3 月 30 日(30.03.2012) JP
- (71) 出願人: 三菱瓦斯化学株式会社(MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.) [JP/JP]; 〒1008324 東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 斎藤 千里(SAITO, Chisato); 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 植山大輔(UEYAMA, Daisuke); 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 十亀 政伸(SO-GAME, Masanobu); 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 馬淵 義則(MABUCHI, Yoshinori); 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 加藤 禎啓(KATO, Yoshihiro); 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1

号 三菱瓦斯化学株式会社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 稲葉 良幸, 外(INABA, Yoshiyuki et al.); 〒1066123 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 23 階 TMI 総合法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロシヤ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: RESIN COMPOSITION, PREPREG AND LAMINATE

(54) 発明の名称: 樹脂組成物、プリプレグ及び積層板

(57) Abstract: Provided are: a resin composition which is capable of easily providing, with good reproducibility, a laminate, a printed wiring board or the like that has not only excellent heat dissipation characteristics but also good moldability, good mechanical drilling processability and excellent appearance; and a prepreg, a metal foil-clad laminate and the like, each of which uses the resin composition. A resin composition which contains (A) a cyanic acid ester compound, (B) an epoxy resin, (C) a first inorganic filler, (D) a second inorganic filler and (E) a molybdenum compound, and wherein the ratio of the average particle diameter of the first inorganic filler (C) to the average particle diameter of the second inorganic filler (D) is from 1:0.02 to 1:0.2.

(57) 要約: 放熱特性に優れるのみならず、成形性やメカニカルドリル加工性が良好で、且つ、外観にも優れる積層板やプリント配線板等を簡易に且つ再現性よく実現可能な樹脂組成物、これを用いたプリプレグならびに金属箔張積層板等を提供する。シアノ酸エステル化合物 (A)、エポキシ樹脂 (B)、第一の無機充填材 (C)、第二の無機充填材 (D) 及びモリブデン化合物 (E) を含有し、第一の無機充填材 (C) と第二の無機充填材 (D) の平均粒子径の比が、1 : 0.02 ~ 1 : 0.2 である樹脂組成物。



WO 2013/146700 A1